



# Technical Data Sheet

## FeedBond® SP-2000A-YKC2

### 導電銀漿

#### A. 產品說明

**FeedBond® SP-2000A-YKC2** 是一種高效能低溫固化(<90°C)無鹵素導電銀漿，能提供極佳的彎折性與阻抗值，可廣泛應用於薄膜開關，電腦鍵盤線路等軟板線路與硬板線路製作，且絲網印刷具有良好印刷性。該漿料對基材(ABS、PC、PVC、PS、FR-4、ITO)表面具有牢固的附著性。

#### B. 產品特性

- 銀灰色漿狀
- 低溫固化(<90°C)
- 低電阻、可與 ITO 附著性極佳
- 印刷性佳
- 符合 RoHS 規範 ; Halogen free

#### C. 產品規格

固化前特性	單位	規格	檢測方式	Feedpool SP-2000A-YKC2	競品 YK-AG-21
黏度 (5 rpm)	cps	5000~15000	Brookfield DV-III/CP-51 @25°C	8187	
固含量	%	65~80	烘箱烘烤 150°C/60min	77.1	
固化溫度	°C	90	-	-	
固化時間	min	10	-	-	

固化後特性	單位	規格	檢測方式	Feedpool SP-2000A-YKC2	競品 YK-AG-21
附著性	-	4B	百格測試(3M tape #600)	4B	<4B
體積電阻	Ω-cm	<7.0E-05	ASTM D257-78	3.5E-05	3.7E-05
表面電阻	mΩ/□	<50	ASTM D257-78	25	27

\*備註 1: 以上固化條件僅為建議，固化條件可能會因為客戶的使用方式及固化設備等而有所不同。

\*備註 2: 電阻可客製化。



## D. 作業事項

- 作業方式:建議先將漿料攪拌均勻再進行印刷。
- 建議絲印參數:

漿料攪拌時間	10~15min, speed 200~300 rpm
絲網類型	聚酯絲網或不銹鋼絲網
網目	150~250 mesh
印刷厚度	8~15 um

- 清洗方式：建議以 DBE 與丙酮交互使用清潔印刷器具。

## E. 基本訊息

1. 使用條件與實際數值仍依客戶使用環境與程序為準。
2. 使用該產品前須將基材表面清潔乾淨。

## F. 貯存

1. 將本油墨放置於密封容器中，儲存溫度5°C~25°C(冷藏最好)。
2. 從容器中取出的產品在使用過程可能被汙染，請勿將使用過的產品倒回原容器。
3. 儲存壽命6個月。

## G. 包裝

1Kg 塑膠罐或根據客戶要求，如需要詳細資料請聯絡 **Feedpool** 客戶服務及銷售部門。

## H. 應用

### ITO film adhesion test:

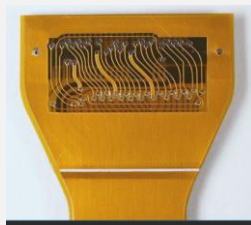


Feedpool : SP-2000A-YKC2



Competitors : YK-AG-21

### Application diagram:



Membrane switch, / flex board line



Computer keyboard line